

广发证券股份有限公司
关于广东利扬芯片测试股份有限公司
2022 年度持续督导跟踪报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”或“公司”）向不特定对象公开发行可转换公司债券的保荐机构，已承接利扬芯片原保荐机构中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，保荐机构履行持续督导职责并出具本次 2022 年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构在承接持续督导工作后，已建立健全并有效执行持续督导工作制度、针对利扬芯片制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与利扬芯片签订了保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解利扬芯片经营情况，对利扬芯片开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022 年度利扬芯片在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况

序号	工作内容	持续督导情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2022 年度利扬芯片在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导利扬芯片及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促利扬芯片依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对利扬芯片的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，利扬芯片的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促利扬芯片严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件

序号	工作内容	持续督导情况
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	承接持续督导后，保荐机构对利扬芯片的信息披露文件进行审阅，不存在应向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2022 年度，利扬芯片及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2022 年度，利扬芯片及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2022 年度，经保荐机构核查，利扬芯片不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2022 年度，利扬芯片未发生前述情况

序号	工作内容	持续督导情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	承接持续督导工作后，保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求
	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	2022 年度，利扬芯片不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2022 年度，保荐机构和保荐代表人未发现利扬芯片存在重大问题。

三、重大风险事项

公司目前面临的主要风险因素如下：

（一）与发行人相关的风险

1、技术风险

（1）研发人员流失风险

集成电路产业发展迅速，工艺、技术及产品的升级和迭代速度较快，公司要保持持久的竞争力，必须不断加大人才培养和引进力度。目前，与广阔的市场空间相比，专业测试研发技术人员严重匮乏。公司的测试解决方案开发、测试技术创新和前瞻性研究主要依托以核心技术人员为骨干的研发团队。公司测试技术复杂程度高、研发难度大，掌握该等技术需要多学科的知识积累和多年的技术沉淀。如果同行业竞争对手通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，或其他因素导致公司研发技术人员大量流失，将对公司经营造成重大不利影响。

（2）技术泄密风险

公司所处的集成电路测试行业为典型的技术密集行业，核心技术是企业保持竞争优势的基础，核心技术人员的稳定性及核心技术的保密性对公司的发展尤为重要。经过多年的技术创新和研发积累，公司的测试方案开发能力与测试技术水平已跻身国内先进行列。公司十分重视对核心技术的保护工作，制定了保密制度，与核心技术人员签署了保密协议，并对其离职后做出了竞业限制规定，以确保核心技术的保密性。但是由于技术秘密保护措施的限制性、技术人员的流动性及其他不可控因素，公司仍存在核心技术失泄密的风险。若公司在经营过程中因核心技术信息保管不善、核心技术人员流失等原因导致核心技术泄密，将会直接影响公司的市场竞争优势，对公司业务造成不利影响。

2、经营风险

（1）公司经营业绩下滑风险

报告期各期，公司的营业收入分别为 25,282.54 万元、39,119.81 万元和 45,243.50 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 5,194.72 万元、10,584.19 万元和 3,201.67 万元。2022 年度归属于母公司股东的净利润同比下滑 69.75%。公司于 2023 年 4 月 29 日披露了《广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第一季度报告》（未经审计），公司 2023 年 1-3 月营业收入同比下降 4.27%，归属于母公司股东的净利润同比下降 39.57%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降 58.20%。

公司经营受到宏观经济环境、行业周期性波动、行业市场竞争情况、市场需求变化等诸多因素影响，规模增长也带来了市场开拓、研发和折旧摊销等费用支出增长的挑战，公司经营业绩存在持续下滑甚至短期内亏损的风险。

（2）销售区域集中风险

报告期内，公司主营业务收入金额分别为 24,439.91 万元、37,432.25 万元和 43,394.25 万元，其中来自华南地区的收入金额分别为 17,286.81 万元、25,594.19 万元和 27,532.62 万元，占当期主营业务收入的比重分别为 70.73%、68.37%和 63.45%，存在销售区域集中的风险。若未来华南地区市场环境发生重大不利变化，

将对公司业绩带来不利影响。

（3）公司发展需持续投入大量资金风险

集成电路测试行业属于资本密集型行业。为了扩大测试规模，保证充足的产能以满足订单测试需求，提高市场竞争力，公司需不断添置测试机、分选机和探针台等测试平台。报告期各期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 18,918.32 万元、47,728.75 万元和 42,957.50 万元。公司如果未来不能获取足够的经营收益，或者融资渠道、规模受限，导致资金投入减少，可能对公司的发展和市场竞争力产生不利影响。

（4）进口设备依赖风险

报告期内，公司产能持续扩张，固定资产投资规模持续增长。公司现有机器设备以进口设备为主，主要供应商包括 ADVANTEST CORPORATION（爱德万）、Teradyne（Asia）Pte. Ltd.（泰瑞达）、TOKYO ELECTRON LIMITED（东京电子）等国际知名测试设备厂商，相关设备系公司开展业务的关键设备。截至本持续督导跟踪报告出具日，设备及募集资金投资项目所需进口设备未受到管制。若未来国际贸易摩擦加剧，可能导致公司所需的测试设备出现进口受限的情形，将对公司生产经营产生不利影响。

（5）客户产品保管不善的风险

公司在为客户提供晶圆测试和芯片成品测试服务过程中，需替客户保管被测试的晶圆和芯片，公司承担保管风险。虽然公司已建立完善的仓储管理制度，并针对客户产品购买了财产保险以降低风险，但由于晶圆和芯片价值高，存放过程中对温度、湿度等环境要求高，若公司在保管期间因管理不善或其他原因导致晶圆或芯片遗失、毁损的，公司将承担赔偿责任，可能对公司经营业绩产生不利影响。

（6）劳动力成本上升导致经营利润下滑的风险

随着社会经济的迅速发展和人力资源及社会保障制度的不断规范和完善，社会人均薪酬水平逐步提高。同时为保持人员稳定、吸收优秀人才，公司的员工薪酬待遇也可能进一步提高。报告期各期末公司员工人数分别 761 人、910 人和

1,163 人，劳动力成本上升可能会导致未来经营利润下滑的风险。

3、财务风险

(1) 毛利率波动风险

报告期内，公司毛利率分别为 46.10%、52.78%和 37.24%，受下游需求变动、测试产品结构变动及设备产能利用率影响，公司毛利率存在一定波动。公司测试的芯片种类和型号较多，使用不同测试平台的毛利率存在一定差异，产品结构、中高端测试平台收入结构的变化将影响公司主营业务毛利率。其次，公司成本结构中以固定性成本为主，主要包含测试设备折旧、厂房租金等。若公司未来营业收入规模出现显著波动，或流失先进制程芯片测试项目等高毛利率业务，或新增测试设备稼动率较低，公司将面临毛利率发生波动或无法维持现有毛利率水平的风险。

(2) 应收账款回收风险

报告期各期末公司应收账款账面价值分别为 6,580.85 万元、9,616.71 万元和 14,276.17 万元，占总资产的比例分别为 6.03%、7.63%和 8.43%，应收账款规模随公司业务规模扩大而增加。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款未来有可能进一步增加。如果公司的应收账款不能及时足额回收甚至不能回收，将对公司的经营业绩、经营性现金流等产生不利影响。

(3) 税收优惠政策变化及所得税税率上升的风险

公司及子公司上海利扬创、东莞利致均为高新技术企业，适用 15%的企业所得税税率；利扬香港首个 200 万元港币盈利的利得税税率降低至 8.25%，其后的利润继续按 16.5%征税。

若未来相关税收优惠政策收紧，或者公司及子公司未能持续满足高新技术企业资质要求，将对公司净利润造成一定不利影响。

(4) 负债金额增加较快的风险

报告期内，随着公司业务的扩张，公司不断加大固定资产的投入，公司通过银行借款等弥补自有资金不足，报告期各期末公司的负债金额分别为 11,572.83

万元、20,935.43 万元和 60,703.94 万元，2021 年末和 2022 年末负债规模较上期末同比分别增长 80.90%和 189.96%，增长较快。报告期内公司资产负债率分别为 10.60%、16.61%和 35.84%，呈上升趋势。若公司未能适度地控制负债规模、未能合理地调整资产与负债的匹配程度，则可能发生偿债能力降低的风险。

(二) 与行业相关的风险

1、集成电路行业周期性波动风险

公司主要业务是向集成电路行业中的芯片设计企业提供测试服务，公司发展与国内集成电路设计公司的发展高度相关。国内集成电路行业存在周期性波动的特点，如果未来行业出现周期性下行，则会对发行人的经营业绩产生不利影响。

2、集成电路行业竞争风险

集成电路产业链中第三方专业测试厂商、封测一体公司、晶圆代工企业、IDM 厂商和芯片设计公司等模式的厂商均可提供晶圆和芯片成品的测试服务，其中晶圆代工企业、封测一体公司和第三方专业测试厂商都能对外提供晶圆测试或者芯片成品测试服务，都是服务于芯片设计公司；而 IDM 厂商和芯片设计公司主要为满足公司内部测试需求配置一定的测试产能。各类厂商的主营业务和技术特点各不相同，相比于其他四类，国内第三方专业测试厂商起步较晚，分布较为分散且规模较小。

若公司未来无法在生产规模、获客能力等方面保持并扩大竞争优势，将有可能在竞争中处于不利地位。

3、不可抗力风险

地震、台风、海啸、自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力的下降。

四、重大违规事项

2022 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度
营业收入	452,434,959.51	391,198,103.07	15.65%
归属于上市公司股东的净利润	32,016,650.62	105,841,853.17	-69.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,479,744.21	91,664,749.97	-76.57%
经营活动产生的现金流量净额	260,184,587.81	191,780,317.87	35.67%
主要会计数据	2022 年末	2021 年末	增减变动幅度
归属于上市公司股东的净资产	1,078,540,311.43	1,050,689,997.99	2.65%
总资产	1,693,884,882.86	1,260,044,307.09	34.43%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.78	-70.51%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.77	-70.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.67	-76.12%
加权平均净资产收益率（%）	3.04	10.49	减少 7.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.04	9.08	减少 7.04 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	14.93	12.46	增加 2.47 个百分点

上述主要财务指标的变动原因如下：

归属于上市公司股东的净利润同比减少 69.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 76.57%，主要原因包括：（1）2022 年，受宏观经济环境变化影响，全年芯片行业特别是消费电子芯片去库存周期较长，在固定成本为主的成本结构下，公司产能利用率有所下降从而使得当年销售毛利率有所下滑；（2）为增强公司综合研发实力，公司高度重视研发体系的建设，结合不同应用领域的芯片测试技术开发需求，不断加大中高端芯片测试方案的研发投入；（3）因实施 2021 年股权激励计划，2022 年度公司新增股份支付费用 2,952.49 万元；（4）2022 年度公司通过长期借款等方式补充自有资金不足，有息负债增加，导致财务费用较上年同期增加。

2022 年末公司总资产同比增加 34.43%，公司资产规模随着公司在测试领域的持续布局和持续的资产投入而增加。

2022 年度公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别减少 70.51%、70.13%和 76.12%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。

2022 年度公司加权平均净资产收益率较 2021 年末减少 7.45 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益较 2021 年末减少 7.04 个百分点，主要原因系净资产规模增加同时归属于上市公司股东的净利润减少所致。

2022 年度公司研发投入为 6,755.26 万元，同比增长 38.56%，研发费用占营业收入的比例同比增长 2.47 个百分点。为增强公司综合研发实力，公司高度重视研发体系的建设，结合不同应用领域的芯片测试技术开发需求，不断加大中高端芯片测试方案、测试设备的研发投入，2022 年度公司研发费用中的工资薪金、折旧费用等均有所增加。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、测试平台优势

公司成立于 2010 年，经过 10 多年发展，积累了较多的测试平台，相比于国内其他独立第三方测试公司，公司测试平台类型较为多样和丰富，可满足市场上不同设计公司的测试需求，目前公司拥有爱德万 93K、T2K、T5830、T53 系列、EVA，泰瑞达 Ultra flex、J750、Magnum，致茂 33 系列，恩艾 STS、PXI 系列，华峰测控 STS8200、STS8300，胜达克 Astar，东京电子 P12、Precio XL，东京精密 UF200、UF3000、AP3000，科休 MT9510，爱普生 8000 系列，四方 8508，鸿劲 1028C 等测试设备，具有数字信号芯片、模拟信号芯片、数模混合芯片、射频芯片等的测试能力。

2、本土市场客户资源及服务优势

经过多年的发展，我国本土电子产业成长迅速，已成为电子产品生产制造大

国，本土芯片设计企业的技术能力和市场能力迅速发展壮大，成为公司最主要的目标客户群。相对于海外竞争对手，公司一方面更加贴近、了解本土市场，能够快速响应客户需求，提供充分的服务支持，可以稳步占据供应链的关键位置；另一方面，公司与本土电子产品制造企业在企业文化、市场理念和售后服务等方面更能相互认同，业务合作通畅、高效，形成了密切的且相互依存的产业生态链。

由于集成电路行业具有技术含量高的特点，并且集成电路设计企业为了抢占市场先机，通常对测试企业的测试能力、质量管理体系、交期、服务效率等方面有着较为严格的要求。公司作为第三方专业测试企业，拥有公正的身份立场，具有较强的服务意识和较高的服务效率，能够全面满足客户对测试公正立场的要求。公司高度重视对客户资源的管理与维护，长期通过参与客户工程技术研讨、进行新产品试验等有效措施加强与客户的互动性，通过测试为客户创造更多价值，提升客户粘性；同时，基于产能保证、技术保密性和更换供应商的操作成本考虑，这种战略合作一般具备较高的稳定性。因此，公司的客户忠诚度比较高，为公司业务的持续发展奠定巨大的优势，是公司的核心竞争力之一。

3、贴近集成电路产业链的地缘优势

中国集成电路产业已获得长足发展，在全球产业链中的地位举足轻重，集成电路产业链的晶圆代工制造与芯片封装、电子终端产品分别集中于国内的华东、华南地区，目前我国境内最主要的晶圆代工基地集中在华东，包括中芯国际、上海华力、华虹半导体、台积电和华润上华等；长电科技、通富微电等是以华东为中心的封装基地，该等企业为国内芯片设计公司提供专业的晶圆代工和封装代工服务。

华南地区主要以深圳、东莞为中心，聚集着如比亚迪、富士康等电子组装基地；另外，以手机为消费电子代表的华为、VIVO、OPPO等总部设在华南，而且集成电路全国总分销集中在深圳，有助于芯片设计公司快速响应终端市场。

公司分别以粤港澳大湾区（广东省东莞市）和长三角（上海市嘉定区）两个中心建立四个测试技术服务基地，既能毗邻终端客户提供服务，又能贴近前端晶圆制造和封装实现快速响应。公司多年来持续在第三方专业测试领域深耕，具备高质量且高性价比的集成电路测试量产能力，稳定的核心技术团队，辐射上下游

的快速响应能力，是核心竞争力的体现。

公司在地理上贴近集成电路产业中心，在产品质量、交货速度、个性化支持、售后服务等方面也得到了客户的充分认可。同时，公司拥有贴近集成电路产业中心的地缘优势，便于获取高素质研发人才的加盟，处于有利的竞争地位，形成了一定的品牌效应。

4、技术研发优势

公司在行业内具备一定的技术研发优势，拥有较强的自主研发测试方案的能力。高效、专业的测试方案需要企业具备深厚的技术底蕴和经验积累，公司长期致力于测试方案开发，具备在较短的产品开发周期内快速开发出满足市场应用的测试方案的核心开发能力。公司较早实现了行业内多项领先技术产品的测试量产，在给客户提供关键技术测试方案上具有突出表现，为客户抢占市场先机及提升竞争力提供有力保障。

公司已经在 5G 通讯、计算类芯片、工业控制、传感器、智能控制、生物识别、信息安全、北斗导航、车用芯片等新兴产品应用领域取得测试优势，未来公司将加大力度继续布局传感器（MEMS）、存储（Nor/Nand Flash、DDR 等）、高算力（CPU、GPU、AI 等）等领域的集成电路测试。

为了保障公司具备长期的市场竞争力，公司高度重视技术的持续创新。未来，公司将进一步增强研发能力，提升现有核心业务的技术水平，开发更多的新型集成电路测试方案，为客户提供更优质的服务，巩固和扩大自身的竞争优势。

5、人才优势

公司拥有多名在集成电路测试行业从业经验长达十余年的资深技术人员和专业的集成电路测试方案开发团队，构成公司技术研发的核心支柱力量；另外，公司早在 2019 年已组建先进技术研究院，专注于当前和未来集成电路行业先进制程、先进封装、先进应用的芯片产品做前瞻性测试研究。公司研发团队具备扎实的研发功底和经验积累，有利于提升公司的自主创新能力，通过不断开发出更具创新性的测试方案，赢得市场广泛认可，为公司带来更多的业务需求。

公司以完善的研发团队为依托，具备扎实的技术储备和丰富的行业经验。公

司核心技术人员主要来源于自主培养，已形成由资深、高级、初级工程师组成的人才梯队，能满足公司在技术快速发展对测试人才源源不断的需求。

集成电路测试行业参与者需要具备丰富的测试经验，以提高测试品质的可靠性和对新产品需求的响应速度，能够在较短的产品开发周期内快速开发出满足市场应用的测试方案，以适应测试方案的需求并实现大规模批量测试。公司研发团队能开发基于多种高端测试平台的解决方案，并可实现各平台之间的转换，具备丰富的各种类型芯片产品测试方案的开发经验。同时，公司还拥有较强的自动化设备硬件开发团队，公司自主研发设计的条状封装产品自动探针台、3D 高频智能分类机械手等集成电路专用测试设备已运用到公司的生产实践中。

6、公司与第三方专业测试服务厂商的比较优势

与公司同为第三方专业测试厂商的公司相比，一方面，目前中国台湾存在多家规模较大的专业测试上市公司，如京元电子、矽格、欣铨等，与中国台湾测试公司相比，公司具有区位和文化优势，境内的芯片设计公司也迎来高速增长。由于芯片设计公司需要与集成电路测试公司进行密切地合作，在测试的过程中需要深入沟通具体技术问题，考虑到芯片设计领域的技术保密性，我国境内越来越多的大型芯片设计公司未来会逐渐将测试需求转向境内，优先选择境内的测试公司；另一方面，公司与国内第三方专业测试厂商相比，由于境内第三方专业测试厂商普遍成立时间较晚，规模较小，公司具有一定的规模优势和市场开拓优势。

7、公司与封测一体公司、晶圆代工企业、IDM 厂商、芯片设计公司的比较优势

(1) 与封测一体公司相比：封测一体公司更多专注于封装领域的研发，其测试更多是属于自检，也就是在封装完成后进行配套测试检验，测试的内容主要是芯片的基本电性能测试和接续测试。公司作为独立第三方专业测试公司，专注于测试领域的研发，且多为自主研发测试方案，在测试服务技术实现路径上与封测一体公司存在差异；公司在产业链的位置为独立第三方，仅提供专业测试服务，测试报告更加中立、客观；

(2) 与晶圆代工企业相比：独立第三方专业测试公司可选择的测试平台相

对较多，具有较高的匹配度，交期也具有明显优势；

(3) 与 IDM 厂商相比：独立第三方专业测试可接受订单的范围较广，IDM 厂商一般不接受外部订单，测试产能规划全部服务于集团内部自身设计和制造的产品，相比于 IDM 厂商，公司测试服务客户范围更加广阔；

(4) 与芯片设计公司相比：鉴于对商业和技术机密的保护，同类产品的芯片设计公司一般不会将测试需求交付于此种模式的测试厂，因此此类测试厂有业务开展的局限性，扩张潜力不足，产能利用率不高。而公司可与各类设计公司合作，业务开展较广，测试平台稼动率较高。

(二) 核心竞争力变化情况

2022 年度，公司的核心竞争力未发生重大变化。

七、研发支出变化及研发进展

公司研发投入情况如下：

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	67,552,565.14	48,752,947.18	38.56
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	67,552,565.14	48,752,947.18	38.56
研发投入总额占营业收入比例 (%)	14.93	12.46	增加 2.47 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

2022 年度，公司进一步加强创新能力建设和研发投入，具体专利和软件著作权的进展情况如下：

单位：个

项目	本年新增		累计数量	
	申请数	获得数	申请数	获得数
发明专利	19	4	69	14
实用新型专利	78	71	197	160
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	5	8	23	21

项目	本年新增		累计数量	
	申请数	获得数	申请数	获得数
其他	0	0	0	0
合计	102	83	289	195

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

（一）募集资金年度使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元，2022 年度募集资金具体使用和结余情况如下：

单位：万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	47,094.26	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	46,959.48
	利息收入净额	B2	104.66
本期发生额	项目投入	C1	239.44
	利息收入净额	C2	-
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	47,198.92
	利息收入净额	D2=B2+C2	104.66
应结余募集资金	E=A-D1+D2	-	
实际结余募集资金	F	-	

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广东利扬芯片测试股份有限公司	中国银行股份有限公司 东莞万江支行	693873847628	0	已注销
	中国建设银行股份有限公司 东莞万江支行	44050177610800001824	0	已注销

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	54010078801500001485	0	已注销
上海利扬创芯片测试有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610800001848	0	已注销
合计			0	/

截至 2022 年 12 月 31 日，利扬芯片募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金《管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况如下：

单位：股

姓名	职务	2022 年初持股数	2022 年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因
黄江	董事长	41,343,800	41,343,800	-	
瞿昊	董事	6,918,400	5,918,400	-1,000,000	减持
黄主	董事	4,362,000	4,362,000	-	
张亦锋	董事、总经理	47,408	117,408	70,000	股权激励归属
辜诗涛	董事、董事会秘书、财务总监	1,097,400	1,120,600	23,200	股权激励归属
袁俊	董事	160,000	180,000	20,000	股权激励归属
郑文	独立董事	-	-	-	
游海龙	独立董事	-	-	-	
郭群	独立董事	-	-	-	

姓名	职务	2022年初持股数	2022年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因
张利平	监事会主席	6,818,400	5,113,800	-1,704,600	减持
徐杰锋	监事	3,850,000	3,850,000	-	
邓先学	职工监事代表	15,000	15,000	-	
卢旭坤	研发部总监	250,000	205,900	-44,100	减持、股权激励归属
郑朝生	硬件部总监	40,000	58,400	18,400	股权激励归属

注：黄江为公司董事长，亦为公司控股股东、实际控制人

2022年度利扬芯片控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试股份有限公司
2022年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：

袁军

袁军

易达安

易达安



2023年5月22日